

龔皇光(Kung, Huang-Kuang)教學、研究與服務資料

2016/11/15

現職： 正修科技大學 工學院 院長

最高學歷：美國德州休士頓大學機械工程博士

主要經歷：

教育部「TDK盃全國大專院校創思設計及製作競賽」委員暨裁判長

教育部「全國高中職智慧鐵人創意競賽」委員暨國際評審

經濟部「工業局SBIR計畫」審查委員

經濟部「楠梓加工出口區跨領域」專家委員

內政部「公共工程委員會」審查委員

中華民國航空太空學會「台灣無人飛機創意設計競賽」委員暨評審

「中華民國中國工程師學會」高雄市分會理監事

「財團法人資訊工業策進會」技術服務團專家

「國立中山大學機械與機電工程學系系友會」理事長

「鳳山高中校友總會」理事長

「全國學生模具實務專題競賽」評審

「高雄國際發明展」國際評審

教育部「專科學校畢業程度學力鑑定考試」命題召集委員

教育部「高級中等學校教師甄選」命題委員

教育部「技專院校學生技術實作競賽」諮詢委員

正修科技大學工程研究科技中心主任(2001-2013)

正修科技大學機械工程系/機電研究所系主任兼所長(1999-2012)

正修科技大學生物醫學暨機電工程學位學程籌備主任(2010-2012)

德國阿亨工業大學“Industry 4.0” Education Programme Expert

美國Babson College “Entrepreneurship Educators” Expert

世界名人錄Who's Who in the World. (2006)

Editor, International Symposium in Science and Technology

Editor, Machinery and Automation Journal

Reviewer, IEEE, Transactions on Semiconductor Manufacturing Journal



Reviewer, Microelectronic Reliability Journal

專長:

- (1) 機械固力
- (2) 材料CNS/ASTM/JIS/DIN/ISO17025規範試驗
- (3) 半導體封裝力學分析(ANSYS/MOLDEX3D軟體應用)
- (4) 複合材料力學分析及高溫應用
- (5) 精密機械CAD/CAM /CAE/CIM整合
- (6) 應用3D創意設計於貴金屬飾品製造(Rhino/RhinoGold軟體應用)

聯絡:E-MAIL: hkkung@gcloud.csu.edu.tw / 07-7358800#3315 / 0921577069

1. 獲獎

1. 「高雄國際發明展」貢獻獎(2016)
2. 正修科技大學『教學研究績優獎』17次。(1998、2000-2015年度)
3. 『103學年度專題製作競賽』「特優獎」。(2014)
4. 正修科技大學『遴聘業界專家協同教學計劃特色案例』第1名。(2014)
5. 教育部『特殊優秀教學研究人員』彈性薪資獎勵。(2012-2013)
6. 『102學年度技職校院專題製作競賽』「特優獎」。(2013)
7. 韓國『首爾國際發明展』金牌獎。(2013)
8. 『台灣人形機器學會亞洲機器人運動競技大賽』「佳作」。(2013)
9. 『經濟部工業局2013年產業人力扎根計畫』績優計畫獎。(2013)
10. 『101學年度台灣區機器人運動競技大賽』機器人創意競賽佳作獎。(2012)
11. 『101學年度台灣區機器人運動競技大賽』智高遙控機器人佳作獎。(2012)
12. 『100學年度技職院校專題製作競賽暨成果展』佳作獎。(2012/05)
13. 『2012全國智慧型機器人大賽大專組機器人程式設計』第一名。(2012)
14. 『2012全國智慧型機器人大賽大專組智遙控車撞球』佳作。(2012)
15. 『2012全國智慧型機器人大賽大專組智遙控車撞球』第四名。(2012)
16. 『2012智慧化工具機專題實作競賽』第二名。(2012)
17. 『經濟部工業局2012年產業人力扎根計畫』績優計畫獎。(2012)
18. 『教育部TDK盃第15屆全國大專校院創思設計與製作競賽』獲自動組「創意獎佳作」。(2011)
19. 加『教育部TDK盃第15屆全國大專校院創思設計與製作競賽』獲自動組「競賽獎第四名」。(2011)
20. 『100年智慧型機器人產品創意競賽產業應用組』獲佳作。(2011)
21. 『99學年度台灣區電腦化運動競技大賽清潔機器人程式設計』第4名。(2010)
22. 『99年度全國大專電腦軟體設計競賽乙組』佳作。(2010)
23. 『2010尖端材料科技學會碳谷論壇』論文佳作獎。(2010)
24. 『2010年全國智慧型機器人大賽程式設計項目』第2名。(2010)
25. 『高雄市鳳山高級中學』傑出校友。(2009)
26. 『教育部TDK盃第13屆全國大專校院創思設計與製作競賽』遙控組「創意獎特優」。(2009)
27. 『教育部TDK盃第13屆全國大專校院創思設計與製作競賽』遙控組「競賽獎佳作」。(2009)
28. 『第16屆中國機構與機器科學國際學術會議(CCMMS 2008)暨海峽兩岸第四屆機構學研討會』優秀論文獎。(2008)
29. 『國科會第五屆全國院校工程趣味競賽』創意獎佳作及競賽獎佳作。(2005)
30. 『正修科技大學93學年度學生專題製作競賽』第一名。(2004)
31. 『教育部第八屆全國大專院校創思設計與製作競賽』「大學組最優創意獎、大專組最優創意獎、競賽獎第三名及最佳工作團隊紀律獎」。(2004)
32. 教育部『2004創造力教育博覽會』「創意運動公園作品」。(2004)
33. 『行政院勞委會大學及技專校院辦理就業學程計畫』最優學程計畫獎。(2004)
34. 教育部『九十二年度產學合作成果展』-「多功能特殊水泥漆開發與評估」。(2003)
35. 『教育部第七屆全國大專院校創思設計與製作競賽』競賽獎第四名。(2003)
36. 『正修科技大學92學年度指導學生專題製作競賽』「第一名」及「佳作」二組。(2003)
37. 『正修科技大學91學年度指導學生專題製作競賽』「佳作」三組。(2002)

38. 『正修科技大學90學年度指導學生專題製作競賽』「第一名」及「佳作」二組。(2001)
39. 『第八屆振動與噪音工程學會』最佳論文獎。(2000)
40. 『正修科技大學89學年度指導學生專題製作競賽』「第一名」二組及「佳作」二組。(2000)
41. 『正修科技大學88學年度指導學生專題製作競賽』「第一名」及「佳作」二組。(1999)
42. 『正修科技大學87學年度指導學生專題製作競賽』「佳作」二組。(1998)

2.期刊論文

2.1英文國際期刊

1. JN Lee, CH She, CB Huang, HS Chen, **HK Kung**, 2015, "Toolpath Planning and Simulation for Cutting Test of Non-Orthogonal Five-axis Machine Tool", *Key Engineering Materials Vol. 625 (2015) pp. 402-407.* (EI)
2. JN Lee, MY Guan, CH Huang, HS Chen, **HK Kung**, 2014, "Geometrical Modeling and Multi-axis NC Machining for the Volar Plate of the Distal Radius", *Journal of Chinese Society of Mechanical Engineering.*(EI)
3. JC Hsiung, **HK Kung**, H.S. Chen, 2014, "Application of Cryogenic treatment to enhance the property of a bone saw blade", *Life Science Journal* 2014;11(10). (*SCI*)
4. JC Hsiung, GH Tan, HJ Tzeng, HS Chen, **HK Kung**, 2014, "The study of wear resistance of the artificial knee joint", *Life Science Journal* 2014;11(11). (*SCI*)
5. **HK Kung**, HS Chen, MC Lu, 2013, "The wire sag problem in wire bonding technology for semiconductor packaging", *Microelectronics Reliability*, 53 (2013), pp. 288-296. (*SCI*)
6. **HK Kung**, JC Hsiung, JN Lee, 2013, "An empirical equation of wire sag model for semiconductor packaging with numerical and experimental verification", *IEEE Transactions On Components, Packaging And Manufacturing Technology*, Vol. 3, No. 1, January 2013, pp. 157-167. (*SCI*)
7. JC Hsiung, JG Tzeng, **HK Kung**, HS Chen. , 2013, "A Study of Thermal Spray Coating on Artificial Knee Joints" *Life Sci J* ;10(2):236-241. (*SCI*)
8. HS Chen, CH Huang, JC Hsiung, JN Lee, **HK Kung** 2013, "The performance improvement of the spring fastener for the medical CPU cooling plate", *Life Science Journal*,10(2), pp. 283-289. (*SCI*)
9. JN Lee, CW Luo, HS Chen, **HK Kung** and YC Tsai, 2013, "Developing The Custom-made Femoral Component of Knee Prosthesis using CAD/CAM", *Life Science Journal*,10(2), pp. 259-264. (*SCI*)
10. JC Hsiung, **HK Kung**, HS Chen, KY Chang, 2012, "Applications of Thermal Spray Coating in Artificial Knee Joints", *Life Science Journal*, 9(1), pp.457-463.(*SCI*)
11. YP Sun, KT Yen, **HK Kung**, YC Tsai, KC Lu, CM Du, YC Liang, 2012, "The Muscular Function for Human Knee Movement Revealed from Electromyography: A Preliminary Study", *Life Science Journal*, 9(1), pp.453-456. (*SCI*)
12. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, Y.P. Sun, 2012, "Toolpath Generation and Error Analysis for Five-axis NC Machining of Spatial Cam", *Advanced Science Letters*, Vol. 14, No. 1, pp. 106-111, 2012.
13. HS Chen, JN Lee, CH Huang, **HK Kung**, 2012, "The Application of Arc Spraying to the Hard Facing of Wear-Resistant Multi-layer Plate: A Preliminary Study", *Advanced Science Letters*, Vol. 13, No. 1, pp. 671-674, 2012.

14. HS Chen, YB Tsai, CH Huang, JN Lee, **HK Kung**, 2012, "The Critical Dimension Definition of Femoral for Custom-made Total knee Arthroplasty by the Application of Geometric Modeling", *Life Science Journal*, Vol. 9, No. 2, pp. 196-301. (*SCI*)
15. HS Chen, JN Lee, **HK Kung**, 2011, "Application of Taquchi Method in the Optimization of PTA Hardfacing Process", *Advanced Materials Research*, Vol. 314-316, pp. 86-93. (*EI*)
16. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, 2011, "The Profile Design and Multi-axis NC Machining of Cylindrical Cam with Boat-shape Follower", *Advanced Science Letters*, Vol. 4, 2764-2769. (*EI*)
17. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, 2011, "Geometric Modeling and Five-axis NC Machining for Centrifugal Impeller", *Advanced Materials Research*, Vol. 314, pp. 1556-1561. (*EI*)
18. JN Lee, YC Tsai, HS Chen and **HK Kung**, 2011, "An Integrated Approach of CAD/CAM for Spatial Cam with Oscillating Cylindrical Rollers", *Advanced Materials Research Vols. 201* pp 318-325. (*EI*)
19. BW Huang, **HK Kung**, KU Chang, BK Hsu and JG Tseng, 2009, "Human Granium Dynamic Analysis", *Life Science Journal*, Vol.6, No. 4, pp.28-33. (*SCI*)
20. MHR. Jen, YC Tseng, **HK Kung**, J.-C.Huang, 2008, "Fatigue Response of APC-2 Composite Laminates at Elevated Temperatures", *Composite Part B*, Vol. 39 pp. 1142-1146. (*SCI*)
21. AD Lin, **HK Kung**, J.H. Kuang, 2008/07, "The Effect of the Dynamic Contact Loads and Tooth Surface Hardness on the Running Life of an Engaging Spur Gear Pair", *Machine Design and Research*, Vol. 24, pp. 166-170.
22. **HK Kung**, YP Sun, JN Lee, H.S. Chen, 2008, "A Method to Determine the Sweep Resistance of Wire Bonds for Microelectronic Packaging", *Microelectronic Engineering*, Vol. 85 pp. 1902-1909. (*SCI*)
23. **HK Kung**, BW Huang, 2008, "Vibration in a Cracked Machine Tool Spindle with Magnetic Bearings", *Open Mechanical Engineering Journal*, Vol. 2, pp. 41-48.
24. BW Huang, **HK Kung**, JH Kuang, 2008, "Modal Localization in Mistuned Tube-Array Structures", *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 45, pp. 3192-3202. (*SCI*)
25. **HK Kung**, 2007/07, "Evaluation of sweep resistance of Q Auto-Loop and Square-Loop bonds for semiconductor packaging technology", *Microelectronics Reliability*, Vol. 47, pp. 1103-1112. (*SCI*)
26. BW Huang, **HK Kung**, JH Kuang, 2006, "Stability in a Twisted Periodic Blade System with Cracks", *AIAA Journal*, Vol. 44, No. 7, pp. 1436-1444. (*SCI*)
27. **HK Kung**, JN Lee, CY Wang, 2006, "The Wire Sweep Analysis Based on the Evaluation of the Bending and Twisting Moments for Semiconductor Packaging", *Microelectronic Engineering*, Vol. 83/10 pp. 1931-1939. (*SCI*)
28. **HK Kung**, BW Huang, 2006, "High-Temperature Wire Sweep Characteristics of Semiconductor Package for Variable Loop-Height Wirebonding Technology", *Microelectronic Engineering*, Vol. 83/01, pp. 197-205. (*SCI*)
29. **HK Kung**, BW Huang, 2006/01, "On the Wire Sweep Experiments and Predictions of Gold Wire for Semiconductor Wirebonding Technology", *Materials Science Forum. Vols. 505-507*, pp. 319-324. (*SCI*)
30. **HK Kung**, 2005, "Effects of Surface Roughness on High-Temperature Oxidation of Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composite", *Journal of Composite Materials*, Vol. 39, pp. 1677-1687. (*SCI*)
31. BW Huang, **HK Kung**, AWL Yao, 2005, "Effect of Periodic Drilling Force on Instability

- in a Drilling Process”, Journal of Mechanical Engineering Science, Part C. Vol.219, pp.733-742. (*SCI*)
32. BW Huang, **HK Kung**, 2005, “Mode Localization of a Component Cooling Water Heat Exchanger”, International Journal of Mechanical Sciences Vol. 47, pp. 170 -186. (*SCI*)
 33. **HK Kung**, HS Chen, BW Huang, 2004, “Thermal-Fatigue Oxidation of Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composite”, Journal: Key Engineering Materials, Vol. 261, pp. 1191 -1202. (*SCI*)
 34. HS Chen, **HK Kung**, 2004, “A Study for the Moisture Content of Graphite/Epoxy Composite with Hygrothermal Cycling”, Society of Manufacturing Engineering technical paper TP04PUB47.
 35. BW Huang, **HK Kung**, 2003, “Variations of Instability in a Rotating Spindle System with Various Bearings”, International Journal of Mechanical Science, Vol. 45, No. 1, pp. 57-72. (*SCI*)
 36. MH Jen, KH Yang, **HK Kung**, 1990, "The Temperature Distribution Influenced by Moisture and Vapor Pressure in a Multi-layered Composite Wall", Applied Mathematical Modeling, Vol. 14, pp. 296-303. (*SCI*)

2.2 國際研討會論文

1. JC Hsiung, CK Hsiao, YH Cheng, **HK Kung**, “ Effect of Cryogenic on Temperature Elevation and Wear During Bone Drilling”, 2015 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2015/11/05.
2. JC Hsiung, CK Hsiao, HJ Tzeng, JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, “Influence of Cryogenic Treatment and Coating on Heat Generation and Wear Resistance During Bone Drilling”, 10th International Symposium in Science and Technology 2015, Thailand.
3. **HK Kung**, JC Hsiung, HS Chen, JN Lee, CL Hsieh, “The Advanced Semiconductor Technology and Challenges on Multi-Chip-Module and 3-Dimensional Packaging”, 9th International Symposium in Science and Technology, Taiwan, 2014/8/18-20.
4. JN Lee, CH Huang, HS Chen, **HK Kung**, “Geometry Design for Globoidal Cam with Oscillating Follower Applied to Circular Loom”, 9th International Symposium in Science and Technology, Taiwan, 2014/8/18-20.
5. JC Hsiung, HJ Tzeng, **HK Kung**, HS Chen, “Effect of Cryogenic Treatment on the Performance of Tungsten Carbide Tool”, 9th International Symposium in Science and Technology, Taiwan, 2014/8/18-20.
6. BW Huang, J.G. Tseng, **HK Kung**, YP Ping, XQ Cheng, XQ Zhang, WY Liu, YX Qiu, PR Chen, 2014, ” The Analysis of Ground Vibration Induced by High Speed Rail Train”, 5th International Conference on Advanced Manufacturing, Taiwan, 2014/9/30-10/3.
7. JN Lee, MJ Shie, CH Huang, GS Chen, **HK Kung**, 2014, ” Surface Reconstruction and Five-axis Machining for the Inducer of Centrifugal Pump”, 5th International Conference on Advanced Manufacturing, Taiwan, 2014/9/30-10/3.
8. JC Hsiung, CM Huang, CK Hsiao, HS Chen, **HK Kung**, 2014, ” Effect of cryogenic treatment on thermal exposure and wear resistance during bone drilling”, 5th International Conference on Advanced Manufacturing, Taiwan, 2014/9/30-10/3.
9. JN Lee, CH. She, CH Brian Huang, HS Chen, **HK Kung**, 2013, ” Toolpath Planning and Simulation for Cutting Test of Non-Orthogonal Five-axis Machine Tool”, 5th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology, Taipei, Taiwan, 2013/11/12-15.

10. A I Chanyshv, **HK Kung**, 2013, "Influence of the Medium's Initial Anisotropy and Force of the Friction on Contacts on Intrusion of the Rigid Stamp and the Wedge into the Rigid-plastic Semi-plane", 2013 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2013/11/07.
11. JC Hsiung, **HK Kung**, HS Chen, 2013, "Application of Cryogenic Treatment to Enhance the Property of a Bone Saw Blade", 2013 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2013/11/07.
12. JC Hsiung, GH Tan, HJ Tzeng, HS Chen, **HK Kung**, 2013, "The Study of Wear Resistance of the Artificial Knee Joint", 2013 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2013/11/07.
13. JN Lee, CH B Huang, HS Chen, **HK Kung**, 2013, "Five-axis NC Machining of Cylindrical Cam using the Generating Method", 2013 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2013/11/07.
14. **HK Kung**, JN Lee, HS Chen, FS Chang, S Hsu, 2013, "Development of cleaning robots of ventilation system in Taiwan", 2013 台日韓建築與環境污染防治國際研討會, 2013/10/16 正修科技大學, 高雄市
15. JN Lee, MY Guan, CH B Huang, HS Chen, **HK Kung**, 2013, "Geometrical Modeling and Multi-axis NC Machining for the Volar Plate of the Distal Radius", The 16th International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies (AMPT2013), Sept. 22-26, 2013, Taipei, Taiwan, ROC
16. **HK Kung**, JN Lee, JC Hsiung, HS Chen, 2013, "The study of wire sweep and wire sag of 3D and MCM packages for semiconductor applications", International Symposium in Science and Technology 2013, Kansai University, Osaka, Japan, 2013/08/21-23.
17. WH Lee, YS Wang, HS Chen, **HK Kung**, 2013, "Comparisons of Q-loop, Sloop and M-loop bonds on wire sag of semiconductor packaging", International Symposium in Science and Technology 2013, Kansai University, Osaka, Japan, 2013/08/21-23.
18. YS Wang, WH Lee, JN Lee, **HK Kung**, 2013, "A preliminary study for the mismatch of T-type volar plate and distal radius", International Symposium in Science and Technology 2013, Kansai University, Osaka, Japan, 2013/08/21-23.
19. JN Lee, YJ Lee, **HK Kung**, HS Chen, 2013, "Geometric modelling and four axis NC machining for the helical rotor of turbomolecular pump", International Symposium in Science and Technology 2013, Kansai University, Osaka, Japan, 2013/08/21-23.
20. **HK Kung**, JC Hsiung, JN Lee, HS Chen, 2013, "The predictions of wire sag for semiconductor packaging of 3-dimensional and multi-chip modules", ICEP2013, Osaka, Japan, 2013/04/10-12.
21. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, 2012, "Multi-axis Machining of Helicoids Using the Generating Method", 2012 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, July 11-14, 2012, Kaohsiung Taiwan. (EI)
22. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, 2012, "Application of the Envelope Theory in Machining of Helicoids on Multi-axis Machine Tool", 15th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT2012), 23-26 September 2012, Wollongong, NSW Australia.
23. **HK Kung**, JN Lee, HS Chen, JC Hsiung 2012, "Study of Wire Sweep Relaxation and Rebound for 3-Dimensional/Multi-Chip Module Packages", 2012 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2012/11/08.

24. JC Hsiung, HJ Tzeng, **HK.Kung**, HS Chen, 2012, "The Performance Improvement of CPU Cooling Plate Spring Fastener", 2012 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2012/11/08.
25. CH Huang, JC Hsiung, JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, 2012, "A Study of Thermal Spray Coating on Artificial Knee Joints", 2012 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2012/11/08.
26. YP Sun, KC Lu, KT Yen, CM Du, **HK Kung**, YC Tsai, YC Liang, 2012, "An EMG-Driven Model to Estimate Knee Joint Moment", 2012 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2012/11/08.
27. BW Huang, **HK Kung**, YC Tsai, FS Wang, YT Chen, JG Tseng, 2012, "Destructive Yield Analysis of the Human Knee Meniscus", 2012 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2012/11/08.
28. JN Lee, CW. Luo, HS Chen, **HK.Kung**, YC Tsai, 2012, "Developing The Custom-made Femoral Component of Knee Prosthesis using CAD/CAM", 2012 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 2012/11/08.
29. A I Chanyshv, LL Efimenko, GM Podyminogin, **HK Kung**, 2012, "Determination of the maximum allowed depth of an open pit", 2nd Russia-China Conference on Nonlinear Geomechanics and Geodynamics in Deep Level Mining, 2012/07/02-05, Novosibirsk, Russia.
30. **HK Kung**, HS Chen, MC Lu, CC Li, 2012, "Wire Sweep Analysis for Copper Wire and Pd-coated Copper Wires in Semiconductor Wirebonding Technology", ICEP2012, Tokyo, Japan, 2012/04/20-23.
31. AI Chanyshv, LL Efimenko, GM Podyminogin, HK Kung, 2011, " Estimation of the Maximum-Admissible Height of a Cone-Shaped Layered Dumps Using the Rigid-Plastic Body Model, Proceeding of Geodynamics and Stress State of the Earth's Interior, Russia, 477-482
32. AI Chanyshv, HK Kung, IM Abdulin, 2011, "Post Limit Deformations of Materials and its Applications in the Solving Some Problems of Mechanics", 2011 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 17-22.
33. HS Chen, JN Lee, CH Huang, **HK Kung**, JC Hsiung, 2011, "A Study on the Metallographic Analysis Optimization of Aluminum Alloy", 2011 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 129-134.
34. JC Hsiung, **HK Kung**, HS Chen, KY Chang, 2011, "Applications of Thermal Spray Coating in Artificial Knee Joints, 2011 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 181-190.
35. BW Huang, **HK Kung**, YC Tsai, MY Huang, J.G. Tseng, 2011, "Dynamic Characteristics of a Hollow Femur", 2011 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 213-220.
36. Y P Sun, KC Lu, KT Yen, CM Du, **HK Kung**, YC Tsai, YC Liang, 2011, "The Muscular Function for Human Knee Movement Revealed from Electromyography: A Preliminary Study", 2011 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 228-233.
37. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, 2011, "Toolpath Generation and Five-axis NC Machining for Centrifugal Pump Impeller", 2011 International Symposium on Mechatronics and

- Biomedical Engineering & Applications, Taiwan, 242-248.
38. JC Hsiung, RT Shieh, HT Tzeng, **HK Kung**, HS Chen, 2011, “ Effect of Cryogenic Treatment on the Impact and Wear Properties of Plastic Lenses”, International Symposium in Science and Technology at Kansai University 2011, Japan, 42-45.
 39. JC Hsiung, YT Tung, HT Tzeng, **HK Kung**, HS Chen, 2011, “ A Study of Structure and Process Parameters of Low Stress Spiral Wound Gasket”, International Symposium in Science and Technology at Kansai University 2011, Japan, 239-.
 40. HS Chen, JC Hsiung, **HK Kung**, 2011, “Matching wire sweep design for 3-dimensional and multi-chip module packaging during transfer molding process”, ICEP2011, Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan, 2011/04/13-15.
 41. HS Chen, JC Hsiung, J N Lee, **HK Kung**, 2010, “On the Applications of Ellipse Cross Section of Gold Wire Bond for the Semiconductor Packaging”, the 2010 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2010/11/09.
 42. AI Chanyshhev, **HK Kung**, IM Abdulin, 2010, “Features of Deformation and Failure in the Media (Rocks) with Different Compression and Tension Resistance and the Approaches to Their Description”, the 2010 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2010/11/09.
 43. JC Hsiung, HJ Tzeng, **HK Kung**, HS Chen, JN Lee, 2010, “Void Formation in Die Attach Adhesives”, the 2010 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Kaohsiung, Taiwan, 2010/11/09.
 44. HS Chen, JN Lee, **HK Kung**, JC Hsiung, 2010, “A Study on the Application of PTA Welding to the Wear-Resistant Plate”, the 2010 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2010/11/09.
 45. BW Huang, **HK Kung**, SH Liang, FS Wang, GM Huang, HT Wang, JG Tseng, 2010, “The dynamic study of the femur component of a human knee joint”, the 2010 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Kaohsiung, Taiwan, 2010/11/09.
 46. **HK Kung**, BW Huang, HC Hsu, 2010, “The Effect of Cross Section Geometry of Bonding Wire on Wire Sweep for Semiconductor Packages”, the 2010 IMPACT Conference, Taipei Nangang Exhibition Hall, Taiwan, 2010/10/20-22.
 47. HC Hsu, CC Fu, HS Chang, SL Fu, **HK Kung**, 2010, “Thermal Aging Effect on Copper and Micro Interfacial Frictional Behavior along Cu FAB and Al Pad”, the 2010 IMPACT Conference, Taipei Nangang Exhibition Hall, Taiwan, 2010/10/20-22.
 48. JN Lee, YC Tsai, HS Chen, **HK Kung**, “Geometry Design and Five axis NC Machining of Spatial Cam with Cylindrical Rollers”, The First IFToMM Asia Conference on Mechanism and Machine Science, 2010/10/21-25, Taipei, Taiwan.
 49. JN Lee, HS Chen, **HK Kung**, “The Profile Design and Multi-axis NC Machining of Cylindrical Cam with Boat-shape Follower”, 2010 International Symposium on Mechanical Science and Technology, 2010/09/25-27, Guangzhou, China.
 50. **HK Kung**, HS Chen, 2009, “The Equivalent Diameter of Copper Wire and Gold Wire Based on the Sweep Stiffness Evaluation in Semiconductor Packaging”, the 2009 Electronics Packaging Technology Conference, Singapore, 2009/12/09-11.
 51. HC Hsu, FJ Hsu, SL Fu, **HK Kung**, 2009, “ Hygro-Thermo-Vapor Pressure Coupled Design on Mems-based Pressure Sensor”, the 11th Electronic Materials and Packaging Conference (EMAP 2009), Penang, Malaysia, 2009/12/1-3.
 52. A Sumit, HS Chen, JC Hsiung, **HK Kung**, 2009, “On the study of bond heights and spans

- affecting the wire sag of wire bonds in wirebonding technology”, the 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
53. AI Chanyshhev, **HK Kung**, IM Abdulin, 2009, “Initial isotropic media with different moduli in tension and compression-mathematical description”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Kaohsiung, Taiwan, 2009/11/05.
 54. MC Lu, **HK Kung**, HC Hsu, CT Lee, 2009, “Parametric study and optimal design in wire bonding over head process for stack-die package”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
 55. HS Chen, TH Yeh, JC Hsiung, **HK Kung**, 2009, “The hygrothermal effects on the mechanical properties of Nylon 66”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
 56. JN Lee, YC Tsai, **HK Kung**, HS Chen, JC Hsiung, 2009, “Geometry design and multi-axis machining of cylindrical cam with cylindrical rollers”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
 57. JC Hsiung, YT Tung, HJ Tzeng, HS Chen, **HK Kung**, 2009, “Selection criterion and software development for saealing gasket”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
 58. JM Jou, **HK Kung**, BW Huang, 2009, “ A study on the square matrix type ultrasonic motor”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
 59. JG Tseng, BW Huang, **HK Kung**, 2009, “Tuning PI controller for a rotary position servo system”, 2009 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2009/11/05.
 60. JG Tseng, **HK Kung**, ML Yeh, BW Huang, 2009, “Vibration and Noise Analysis of a Micro Stepping Motor System“, the 2009 International Conference on Advanced Manufacture, Taipei, Taiwan.
 61. **HK Kung**, HS Chen, JM Jou, HC Hsu, 2009, “The Experimental Measurement of Wire Sag of Long Wire Bonds for 3-dimensional and Multi-chip Module Packaging”, the 2009 IMPACT Conference, Taipei Nangang Exhibition Hall, Taiwan, 2009/10/22-23.
 62. **H. Kung**, HS Chen, JC Hsiung, PT Cheng, 2009, “ Effect of Physical and Chemical Aging on Thermomechanical Properties and Long-term Reliability of Polymer Composites”, International Symposium on Science and Technology, Kansai University, Japan, 2009/08/23-25.
 63. JC Hsiung, **HK Kung**, HS Chen, 2009, “Study of Cure Process of Polymeric Die Attach Adhesives”, International Symposium on Science and Technology, Kansai University, Japan, 2009/08/23-25.
 64. **HK Kung**, HS Chen, HC Hsu, 2009, “The semi-experimental analysis of the wire sweep of a wire bond during the transfer molding process”, the International Conference on Electronics Packaging (ICEP) 2009, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan, 2009/04/14-16.
 65. AI Chanyshhev, EA Igonina, **HK Kung**, 2008, “Some results of theroretical research of elasto-plastic behavior of the materials under complex loading”, 2008 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2008/11/05-06.

66. HC Hsu, WY Chang, CT Lee, LS Chen, MC Lu, **HK Kung**, 2008, "Reliability design in ultra thin wire bonding process for mini stack-die package", 2008 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2008/11/05-06.
67. HS Chen, JC Hsiung, **HK Kung**, 2008, "The experimental evaluation of multi-chip effect on sweep stiffness of a wire bond in 3-dimensional packages", 2008 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2008/11/05-06.
68. JC Hsiung, HJ Tzeng, HS Chen, **HK Kung**, 2008, "Cure characterization of polymeric die attach adhesives", 2008 International Symposium on Mechatronic and Biomedical Engineering and Applications, Taiwan, 2008/11/05-06.
69. HS Chen, CB Huang and **HK Kung**, 2008, "The effects of die thickness and bond height on wire sweep in multi-chip module and 3-dimension packages", the 3th IMPACT/ the 10th, EMAP Joint Conference, Taipei Nangang Exhibition Hall, Taiwan, 2008/10/22-24.
70. **HK Kung**, HS Chen, JN Lee, YP Sun, 2007, "The improvement of sweep stiffness and thermomechanical properties of wire bonds for pure gold wire with dopant", the 9th Electronics Packaging Technology Conference, Singapore, 2007/12/10-12.
71. BW Huang, AD Lin, **HK Kung**, JN Lee, JZ Cai, 2007, "Using finite element analysis on vibration and critical load in a micro stepping mill", the 2007 International Conference on Advanced Manufacture, Tainan, Taiwan, 2007/11/26-30.
72. AI Chanyshv, **HK Kung**, 2007, "Structure as a source of features of deformation and physical behavior of materials", the 2007 Taiwan-Russia-Singapore Trilateral Symposium, pp. 1-11, Taiwan, 2007/11/06.
73. HS Chen, CB Huang, **HK Kung**, JC Hsiung, 2007, "Optimization on the bonding strength of UV glue for glass joint by Taguchi method", the 2007 Taiwan-Russia-Singapore Trilateral Symposium, pp. 97-104, Taiwan, 2007/11/06.
74. **HK Kung**, CB Huang, CL Hsu, 2007, "The effect of thermomechanical properties of gold wire on sweep stiffness in semiconductor packaging", the 2007 Taiwan-Russia-Singapore Trilateral Symposium, pp. 76-82, Taiwan, 2007/11/06.
75. **HK Kung**, JC Hsiung, SP Hou, 2007, "The design methodology of bond characteristics for high sweep-resistance wirebond", the 2007 Taiwan-Russia-Singapore Trilateral Symposium, pp. 83-90, Taiwan, 2007/11/06.
76. BW Huang, **HK Kung**, JH Kuang, 2007, "Dynamic Characteristics of a Mistuned Heat Exchanger in Cross-Flow", the ASME 2007 International Design Engineering Technical Conference & Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2007), Las Vegas, Nevada, USA, 2007/09/07-07.
77. **HK Kung**, CH Huang, AI Chanyshv, 2006, "On the Study of Loop Profiles in Improving the Sweep Stiffness of Wire Bond", the 8th Electronics Packaging Technology Conference, Singapore, pp. 472-477, 2006/12/6-8.
78. AI Chanyshv, **HK Kung**, 2006, "Mathematical models of elastic-plastic deformation of material at simple and complex loading", Proceeding of 2006 Taiwan-Russia Research Cooperation Symposium, Taiwan, pp. 12-24, 2006/11/07.
79. **HK Kung**, HS Chen, SM Wu, SY Lin and SP Hou, 2006, "Effect of Geometry Characteristics of a Wire Bond on Sweep Stiffness", Proceeding of 2006 Taiwan-Russia Research Cooperation Symposium, Taiwan, pp. 68-74, 2006/11/07.
80. **HK Kung**, YP Sun, LT Yu, CW Tsai, 2006, "Theoretical Development of Wire Sweep Analysis for Semiconductor Packaging", Proceeding of 2006 Taiwan-Russia Research

- Cooperation Symposium, Taiwan, pp. 75-84, 2006/11/07.
81. HS Chen, **HK Kung**, 2006, "Verification on the Hygrothermal Effect Model for Clamp-up Torque of Bolted Composite Joint", Proceeding of 2006 Taiwan-Russia Research Cooperation Symposium, Taiwan, pp. 108-115, 2006/11/07.
 82. CH Huang, HS Chen, **HK Kung**, 2006, "Evaluation for the Heat Sink Performance of Micro Porous Ceramics MPC", Proceeding of 2006 Taiwan-Russia Research Cooperation Symposium, Taiwan, pp. 152-157, 2006/11/07.
 83. **HK Kung**, HS Chen, CH Huang, 2006, "Effect of bond spans and bond heights on the sweep stiffness of wire bond for semiconductor wirebonding technology", IMAPS Taiwan 2006 International Technical Symposium, Taipei, Taiwan, pp. 61-79, 2006/06/29-07/01.
 84. **HK Kung**, 2005, "The analysis of the bending and twisting moments induced sweep deflection for semiconductor package applications", Proceeding of the 7th Electronics Packaging Technology Conference, pp. 113-118, Singapore, 2005/12/7-9.
 85. **HK Kung**, BW Huang, 2005, "On the Wire Sweep Experiments and Predictions of Gold Wire for Semiconductor Wirebonding Technology", 2005 International Conference on Advanced Manufacture, Taipei, Taiwan, 2005/11/28-12/02,.
 86. BW Huang, **HK Kung**, 2005, "Instability of a Rotating Pre-Twisted Blade with a Crack", Proc. of ISCORMA-3, Paper No. 208, The International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery, USA, 2005.
 87. **HK Kung**, HS Chen, 2004, "Effects of Microcracks and Surface Roughness on Thermal Oxidation of Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composite", proceeding of the 4th Asian-Australasian Conference on Composite Materials, Sydney, Australia, pp.62~67, 2004.
 88. **HK Kung**, HS Chen, BW Huang, 2003, "Thermal-Fatigue Oxidation of Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composite", proceeding of The 5th Conference on Fracture and Strength of Solids, Sendai, Japan, 2003.
 89. **HK Kung**, HS Chen, 2003, "Effects of Surface Roughness on High-Temperature Oxidation of Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composite", proceeding of the SEM Fourteenth International Conference on Composite Materials (ICCM-14), San Diego, CA, USA, ID-1770, pp.1-14, 2003/7/14-18.
 90. HS Chen, **HK Kung**, 2003, "A Study for the Moisture Content of Graphite/Epoxy Composite with Hygrothermal Cycling", proceeding of the SEM Fourteenth International Conference on Composite Materials (ICCM-14), San Diego, CA, USA, ID-1095, pp.1-8, 2003/7/14-18.
 91. **HK Kung**, HS Chen, BW Huang, 2002, "Application of Image Processing Technique on the Evaluation of Fatigue Damage Parameters for AS4/PEEK Composite", The International Symposium on Experimental Mechanics (ISEM2002), Taipei, TAIWAN, pp.139-1~7, 2002/12/28-30.
 92. HS Chen, **HK Kung**, 2002, "A Case Study on the Software Verification of the Computer Servo-control Material Testing Machines", The International Symposium on Experimental Mechanics (ISEM2002), Taipei, TAIWAN, pp.191-1~7, 2002/12/28-30.
 93. HS Chen, **HK Kung**, 2002, "A Hygrothermal Sensitivity Evaluation on the Clamp-up Torque of Bolted Composite Joint", proceeding of the ASC 17th Annual Technical Conference of the American Society for Composites, West Layette, IN, USA, pp.108-1~9, 2002/10/21-23.
 94. HS Chen, **HK Kung**, 2001, "An Analytical Method for Evaluating the Bolt Torque of

- Bolted Composite Joints with Hygrothermal Effect”, The First Taiwan-Japan Workshop on Mechanical and Aerospace Engineering, Tainan, TAIWAN, pp. 160-170, 2001/12/18-19.
95. SJ Lou, YS Lin, L Huang, **HK Kung**, 2000, ”In-Process Micro-Object Machine Vision Measuring System”, The 2000 NAIT Annual Conference, pp.114-118, Pennsylvania, USA, 2000/11/01-4.
 96. **HK Kung**, A Skontorp and SS Wang, 1995, ”High-Temperature Physical and Chemical Aging in Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composites: Experiments and Theory”, Recent Advances in Composite Materials, S.R. White, H.T. Hahn and W.F. Jones, Ed., ASME MD-Vol. 56, pp. 193-202, UCLA, USA, 1995.
 97. X Lu, **HK Kung**, SS Wang, 1994, ”A Homogenization Prediction of Temperature-Dependent Effective Thermoelastic Properties and Microscopic Thermal Stresses in High-Temperature Polymer Composites”, the Ninth Proceeding of the American Society for Composites, 9, pp. 265-274, Delaware, USA, 1994.

2.3 中文期刊及國內研討會議論文

1. 龔皇光、王進猷、熊仁洲、洪傑麟，2015，”半導體金線偏移強化機制之研究”，中華民國力學學會第39屆全國力學會議，國立台灣科技大學。
2. 李政男、黃秋虎、陳鴻雄、龔皇光、羅智文，2015，”圓織機空間凸輪機構之幾何設計與五軸數控加工”，中華民國力學學會第39屆全國力學會議，國立台灣科技大學。
3. 熊仁洲、林信吉、曾信智、龔皇光、陳鴻雄，2015，”工程塑膠取代傳統鋼槽之可行性研究”，中華民國力學學會第39屆全國力學會議，國立台灣科技大學。
4. 李玟萱、王譯賢、**龔皇光**、熊仁洲，2014，”半導體封裝Q型、S型、M型下陷勁度之研究與分析”，中華民國機械工程學會第31屆全國學術研討會，逢甲大學。
5. 王譯賢、李玟萱、**龔皇光**、李政男、陳鴻雄，2014，”遠端橈骨及T型骨板骨折斷裂模擬之研究與分析”，中華民國機械工程學會第31屆全國學術研討會，逢甲大學。
6. 熊仁洲、林信吉、龔皇光、陳鴻雄，2014，”應用超冷處理改善織袋機凸輪耐磨耗性能之研究”，第21屆三軍官校基礎學術研討會。
7. 陳鴻雄、鍾凱隆、黃秋虎、李政男、**龔皇光**，2013，”醫療器材用鈷鉻鉬合金熱鍛製程參數分析”，中華民國機械工程學會第30屆全國學術研討會，國立宜蘭大學。
8. 陳鴻雄、蔡耀彬、林聞信、熊仁洲、**龔皇光**，2013，”膝關節軟骨組織曲面特徵在客製化人工膝關節之設計應用”，中華民國機械工程學會第30屆全國學術研討會，國立宜蘭大學。
9. 熊仁洲、鄭牧謙、曾信智、**龔皇光**，2013，”應用超冷處理提升鎢鋼刀具壽命之研究”，**金屬熱處理期刊**，118(2013)，36-43。
10. **龔皇光**、李哲璋，2012，”銅線及鍍鈮銅線於半導體封裝之彈性偏移、降伏塑性分析與研究”，中華民國機械工程學會第29屆全國學術研討會，國立中山大學。
11. 陳鴻雄、熊仁洲、許榮儒、**龔皇光**，2012，”CPU散熱板彈簧扣件性能提升研究”，中華民國機械工程學會第29屆全國學術研討會，國立中山大學。
12. 熊仁洲、**龔皇光**、陳鴻雄、謝興達，2011，”熔射腹膜技術於人工膝關節鈦合金材料表面改質之分析研究”，**銲接與切割期刊**，Vol. 21，35-42。
13. 陳偉華、熊仁洲、陳鴻雄、**龔皇光**，2011，”模流分析運用於半導體製程之多晶片堆疊與多進澆口之金線偏移研究”，中華民國機械工程學會第28屆全國學術研討會，國立中興大學。
14. 陳鴻雄、張文三、熊仁洲、**龔皇光**，2011，”熱處理對高速火焰熔射碳化鎢塗層機械

- 性質之影響研究”，中華民國機械工程學會第28屆全國學術研討會，國立中興大學。
15. 李哲璋、盧明正、李政男、**龔皇光**，2011，“金線、銅線及鍍鈀銅線於半導體封裝之偏移分析，中華民國全國力學會第35屆全國學術研討會，國立成功大學。
 16. 林奕學、**龔皇光**，2010，“半導體多晶片及三維封裝金線下陷問題之研究與分析“，中華民國機械工程學會第27屆全國學術研討會，台北科技大學。
 17. 陳鴻雄、王約翰、熊仁洲、**龔皇光**，2010，“鋁合金材料金相分析最佳化研究“，中華民國機械工程學會第27屆全國學術研討會，台北科技大學。
 18. 陳鴻雄、楊浚銘、熊仁洲、**龔皇光**，2010，“溫濕度對塑膠扣件潛變性質影響評估“，中華民國機械工程學會第27屆全國學術研討會，台北科技大學。
 19. 陳鴻雄、蔡政益、李政男、**龔皇光**，2010，“電弧熔射技術應用於耐磨複合鋼板製作之研究“，中華民國機械工程學會第27屆全國學術研討會，台北科技大學。
 20. 伍駿騰、**龔皇光**，2010，“模流分析應用於半導體封裝製程之金線偏移探討“，中華民國第34屆全國力學會議論文集，國立雲林科技大學。
 21. 鐘庚晃、陳鴻雄、**龔皇光**，2010，“三維封裝及多晶片模組封裝大跨距對金線下陷問題探討“，中華民國第34屆全國力學會議論文集，國立雲林科技大學。
 22. 黃柏文、**龔皇光**、王逢興、鍾文翰、曾仲葛，2010，“體外振動波影響小鼠造骨細胞之生長“，2010全國精密製造研討會。
 23. 李政男、蔡穎堅、**龔皇光**、陳鴻雄、熊仁洲，2009，”具圓柱嚙合件空間凸輪之幾何設計與五軸加工“，機械零組件通報，Vol. 11 pp.3-11。
 24. 黃郁娟、鐘庚晃、**龔皇光**，2009，“半導體封裝金線橢圓幾何形狀對金線偏移勁度影響之研究與分析“，中華民國機械工程學會第26屆全國學術研討會，成功大學。
 25. 鐘庚晃、侯小屏、**龔皇光**，2009，“半導體多晶片及三維封裝金線下陷問題之研究與分析“，中華民國機械工程學會第26屆全國學術研討會，成功大學。
 26. 陳鴻雄、葉琮合、**龔皇光**、熊仁洲，2009，“溫濕度對尼龍66塑膠材料機械性質影響評估“，中華民國機械工程學會第26屆全國學術研討會，成功大學。
 27. 曾仲葛、**龔皇光**、黃柏文，2009，“軟性構型器“，中華民國機械工程學會第26屆全國學術研討會，成功大學。
 28. 陳鴻雄、蔡鉉丞、**龔皇光**、李政男，2009，“電漿硬面鍍覆技術應用於耐磨複合鋼板製作之研究“，中華民國機械工程學會第26屆全國學術研討會，成功大學。
 29. 曾仲葛、**龔皇光**、黃柏文，2009，”模型驅動企業軟體開發平台“，中華民國第12屆全國機構與機器設計學術研討會，國立中正大學。
 30. 陳鴻雄、何昇輝、鍾庚晃、**龔皇光**，2008，”半導體多晶片及三維封裝晶片厚度與接合高度對金線偏移之影響“，中華民國第32屆全國力學會議論文集，國立中正大學。
 31. 謝其龍、陳鴻雄、熊仁洲、**龔皇光**，2007，” IC封裝金線微元素摻雜對金線偏移之影響“，中華民國第31屆全國力學會議，義守大學。
 32. 葉作文、劉家延、**龔皇光**，2007，”半導體封裝金線幾何形狀對金線高溫偏移勁度之影響“，第10屆全國機構與機器設計學術研討會，國立中興大學。
 33. 陳鴻雄、蕭惟隆、**龔皇光**，2006，”由金線偏移實驗來探討金線跨距及高度對金線偏移勁度之影響“，第9屆全國機構與機器設計學術研討會暨2006年海峽兩岸機構學學術研討會，正修科技大學。
 34. 何昇輝、謝其龍、蔡幸芳、許昭良、**龔皇光**，2006，”半導體封裝Q弧、S弧及M弧之金線偏移分析與實驗“，第九屆全國機構與機器設計學術研討會暨2006年海峽兩岸機構學學術研討會，正修科技大學。
 35. 黃柏文、**龔皇光**、林永達，2006，”致動器模擬之動態特性分析“，第九屆全國機構

- 與機器設計學術研討會暨2006年海峽兩岸機構學學術研討會，正修科技大學。
36. **龔皇光**、郭志鴻、何昇輝，2006，”半導體封裝金線幾何形狀之金線偏移特性分析”，2006第四屆微電子技術發展與應用研討會，高雄海洋科技大學。
 37. **龔皇光**、陳鴻雄、楊協澤、何昇輝，2006，”金線偏移之等效數值分析與實驗驗證”，第五屆海峽兩岸製造技術研討會，高雄第一科技大學。
 38. 楊協澤、陳鴻雄、**龔皇光**、謝其龍，2005，”田口式實驗法在玻璃貼合用UV膠接著強度最佳化評估”，台灣文化精品設計論壇(ISBN 857-21-5167-3)，全華圖書公司。
 39. **龔皇光**、吳思明、周卓明、黃秋虎，2005，”半導體晶線偏移之彎矩及扭矩參數特性分析”，中華民國第29屆全國力學會議論文集，國立清華大學。
 40. 黃柏文、蕭德仁、**龔皇光**、劉碧發，2005，”提升太陽能電池發電功率之參數與機構之研究”，第八屆全國機構與機器設計學術研討會，台北科技大學。
 41. 黃柏文、**龔皇光**，2005，”Parametric Resonance in a Cracked Gas-Bearing Spindle”，第13屆中華民國振動與噪音工程學術研討會，朝陽科技大學。
 42. 楊協澤、陳鴻雄、**龔皇光**，2005，”感光時間對玻璃貼合用UV膠接著性能之影響評估”，東方學報，Vol. 25，pp. 1-15。
 43. 楊協澤、陳鴻雄、**龔皇光**，2004，”強化玻璃UV膠接著強度評估-感光時間影響”，「華文世界向美走」設計教育研討會，東方技術學院。
 44. **龔皇光**、陳華昌，2004，”半導體三維封裝微金線偏移數值分析與實驗證明”，2004 ANSYS-Taiwan User Conference，日月潭涵碧樓。
 45. 黃柏裕、**龔皇光**，2004，”半導體封裝微金線偏移試驗機製作與實驗分析”，中華民國第28屆全國力學會議論文集，國立台灣大學。
 46. 張家賓、**龔皇光**，2004，”微玻璃珠強化矽膠複合材料之機械性能研究”，中華民國第21屆機械工程研討會論文集，國立中山大學。
 47. **龔皇光**、黃柏文、陳鴻雄，2004，”半導體封裝微金線之鬆弛及破斷性質分析與實驗”，中華民國第21屆機械工程研討會論文集，國立中山大學。
 48. 陳鴻雄、**龔皇光**、陳皇男，2004，”複合材料結構板接合扭矩溫濕效應模式驗證分析”，中華民國第21屆機械工程研討會論文集，國立中山大學。
 49. 陳鴻雄、黃柏文、**龔皇光**，2004，”航空用高溫複合材料氧化損傷參數因子探討”，2004航空機械工程學術研討會論文集，空軍軍官學校。
 50. 黃柏文、**龔皇光**、光灼華，2004，”A Study on Vibration of a High Speed Drill in Drilling Process”，2004精密機械與製造技術研討會論文集，墾丁福華。
 51. **龔皇光**、王進猷、黃河穎、郭俊廷，2003，”創意機器人的設計與製作”，正修學報，Vol.16，pp. 121-128。
 52. **龔皇光**、吳子敬、楊政達、王子仁、陳昌驛，2003，”創思設計機器人製作”，中華民國第7屆創思設計與製作競賽論文集，國立台灣科技大學。
 53. **龔皇光**、陳鴻雄，2003，”金線拉伸及金線偏移分析”，中華民國第20屆機械工程研討會論文集，國立台灣大學。
 54. **龔皇光**、黃柏裕，2003，”金線偏移分析與實驗”，中華民國第27屆全國力學會議論文集，國立成功大學。
 55. 陳志冠、**龔皇光**，2003，”Energy Equivalent Modulus of Mixed Mode Crack Problems”，中華民國第27屆全國力學會議論文集，國立成功大學。
 56. **龔皇光**、黃柏文、張俊雄，2003，”應用影像處理技術對高速火焰噴焊碳化鎢-12鈷塗層缺陷評估”，中華民國第3屆精密機械製造研討會論文集，國立中山大學。
 57. 蔡穎堅、林獻源、**龔皇光**、劉文賓，2003，”快速高壓射臘矽膠模具應用在高爾夫

- 球頭製造與研究”，中華民國第3屆精密機械製造研討會論文集，國立中山大學。
58. 黃柏文、**龔皇光**、蔡居萬，2003，”鋁製蜂窩結構設計製造與測試”，中華民國第2003年銲接協會研討會論文集，正修科技大學。
 59. 陳鴻雄、**龔皇光**、黃秋虎，2003，”Performance Evaluation of Multi-Functional Silicon Cement (MSC)”，教育部技專校院92年度產學合作成果展論文集，台北第一世貿展覽館。
 60. 陳鴻雄、**龔皇光**、黃柏文，2002，”溼熱循環下複合材料濕氣含量模擬分析與實測”，中國機械工程學會第19屆全國學術研討會，國立虎尾技術學院。
 61. 黃柏文、**龔皇光**、陳鴻雄，2002，”The Program Construction of Data Bank of Bearing Failure”，機械月刊，Vol.24，pp. 30-35。
 62. **龔皇光**、J.-Y. Pan、吳思明，2002，”影像處理技術對複合材料疲勞損傷應用”，正修學報，Vol.15。
 63. 黃柏文、**龔皇光**，2002，”Parametric Instability in a High Speed Gas Bearing Spindle”，第5屆全國機構與機器設計學術研討會，高雄、國立高雄應用科技大學。
 64. 張俊雄、周孫慶、洪漢斌、**龔皇光**，2002，”高速火焰噴焊碳化鎢-12鈷塗層性質研究”，空軍軍官學校航太工程學術研討會，空軍軍官學校。
 65. **龔皇光**、陳鴻雄、潘柔允、任明華，2002，”碳纖維/聚二醚酮複合材料之疲勞損傷參數探討”，第17屆全國技職研討會，屏東科技大學。
 66. 陳鴻雄、**龔皇光**，2002，”材料試驗機控制軟體驗證-以電腦控制材料試驗機為例”，第17屆全國技職研討會，屏東科技大學。
 67. **龔皇光**，2001，”表面粗度對纖維強化高分子複合材料高溫氧化壽命影響之預測與實證”，正修學報，Vol.14，pp. 93-104。
 68. **龔皇光**、陳鴻雄，2001，”溫度疲勞對複合材料氧化效應之影響”，中國機械工程學會第18屆全國學術研討會，國立台灣科技大學。
 69. **龔皇光**、吳思明、潘柔允、任明華，2001，”影像處理於碳纖維聚二醚酮積層板之疲勞損傷評估”，中國機械工程學會第18屆全國學術研討會，國立台灣科技大學。
 70. 陳鴻雄、**龔皇光**，2001，”複合材料螺栓接合扭矩溼熱敏感度之評估”，中國機械工程學會第18屆全國學術研討會，國立台灣科技大學。
 71. **龔皇光**、羅希哲，2001，”高溫氧化損傷與表面粗度對複合材料氧化量影響之理論預測與實證”，第16屆全國技職研討會，屏東科技大學。
 72. **龔皇光**，2000，”顆粒體積比對複合材料機械性質影響之分析與預測”，正修學報，Vol.13，pp. 79-86。
 73. **龔皇光**、黃柏文、任明華，2000，”由微結構探討表面粗度對複材高溫氧化之影響”，中國機械工程學會第17屆全國學術研討會，國立高雄第一科技大學。
 74. 曾育鍾、林偉煌、**龔皇光**、任明華，2000，”中央鑽孔碳纖維/聚二醚酮複材積層板之高溫疲勞探討”，中國機械工程學會第17屆全國學術研討會，國立高雄第一科技大學。
 75. 黃柏文、**龔皇光**、光灼華，2000，”Dynamic Response of a Cracked Blade-Disk”，第8屆振動與噪音工程學會研討會，國立屏東科技大學。（榮獲第8屆振動與噪音工程學會「最佳論文獎」）
 76. **龔皇光**，1999，”The Curve Fitting Problem of Exponential Prony Series in Viscoelastic Applications”，正修學報，Vol. 12，pp.121-130。
 77. **龔皇光**、任明華，1999，”三維實心與空心玻璃顆粒強化複合材料之有效機械性質分析與預測”，中國力學學會第23屆全國力學會議，國立交通大學。

78. **龔皇光**、任明華，1999，“PRONY級數在黏彈理論應用中的數值近似問題”，中國機械工程學會第16屆全國學術研討會，國立清華大學。
79. 張熙超、林偉煌、**龔皇光**、任明華，1999，“碳纖維/聚二醚酮複合材料積層板鑽孔及溫度效應之破壞機制與機械性質分析”，中國機械工程學會第16屆全國學術研討會，國立清華大學。
80. 彭聖森、林偉煌、**龔皇光**、任明華，1999，“碳纖維/聚二醚酮複合材料積層板溫度效應對疲勞破壞行為之影響”，中國機械工程學會第16屆全國學術研討會，國立清華大學。
81. **龔皇光**，1998，“異向性高分子POLYIMIDE複合材料之高溫氧化及加速測試法”，第13屆全國技職研討會。
82. 龔皇光，1997，“碳纖維強化高分子複合材料物理和化學時效效應”，正修學報，Vol.10，pp. 89-102。
83. **龔皇光**，1997，“Physical and Chemical Aging of Carbon-Fiber Reinforced Polyimide Composites”，高雄五校技職學術論文研討會，高苑技術學院。

2.4 專書及發明專利

1. 中華民國發明第I 445862號，「具暫停角之圓織機凸輪運動曲線設計方法」，李政男、蔡穎堅、**龔皇光**、陳鴻雄、熊仁洲、李建南。(2014/07/21)
2. 中華民國發明第I 404668號，「具暫停角之走肋式繞線凸輪運動曲線設計方法」，李政男、蔡穎堅、**龔皇光**、陳鴻雄、熊仁洲、李建南。(2013/08/11)
3. 中華民國發明第I 404667號，「無暫停角之走溝式繞線凸輪運動曲線設計方法」，李政男、蔡穎堅、**龔皇光**、陳鴻雄、熊仁洲、李建南。(2013/08/11)
4. 中華民國新型第M 398049號「低應力渦捲型墊片」，熊仁洲、劉政治、董昱廷、**龔皇光**、陳鴻雄。(2011/02/11)
5. 中國人民共和國實用新型專利證書第1525884號，「車體連桿機構」，許昭良、**龔皇光**。(2010/09/01)
6. 日本實用新型專利證書第3157958號，「車體連桿機構」，許昭良、**龔皇光**。(2010/02/10)
7. 中華民國新型第M 390323號，「圓織機凸輪滾動機構」，李政男、蔡穎堅、**龔皇光**、陳鴻雄、熊仁洲。(2010/10/11)
8. 中華民國新型第M 375872號，「磨耗機負載穩定機構」，陳鴻雄、羅智文、李政男、**龔皇光**、熊仁洲。(2010/03/11)
9. 中華民國新型第M 371638號，「輪胎切割機」，鄭品聰、**龔皇光**、陳鴻雄。(2010/01/01)
10. 中華民國新型第M 371637號，「輪胎胎側表面剝除機」，鄭品聰、**龔皇光**、陳鴻雄。(2010/01/01)
11. 中華民國新型第M 371636號，「紅外線循環烘乾膠體機」，鄭品聰、**龔皇光**、陳鴻雄。(2010/01/01)
12. 中華民國新型第M 371635號，「輪胎內胎面剝除機」，鄭品聰、**龔皇光**、陳鴻雄。(2010/01/01)
13. 中華民國新型專利證書-新型第M 371634號，「輪胎表面剝除機」，鄭品聰、**龔皇光**、陳鴻雄。(2010/01/01)
14. 中華民國新型專利證書-新型第M 348564號，「差速器模組」，李政男、陳鴻雄、**龔皇光**、熊仁洲、朱國禎、黃偉棋。(2009/11/11)
15. 中華民國新型第M346477號，「定功率移轉式電漿電弧鍍製程之鍍覆間隙控制機構改良」，陳鴻雄、何協勳、**龔皇光**、熊仁洲。(2008/12/11)

16. 中華民國發明第I 290860號，「驅動系統」，龔皇光、周卓明。(2007/12/11)
17. 中華民國發明第I 291284號，「壓電馬達之定子」，龔皇光、周卓明。(2007/12/11)
18. 中華民國新型第M 313219號，「空氣濾清氣之殼板構造」，朱曉明、黃柏文、龔皇光、謝忠明。(2007/06/01)
19. 中華民國發明第I 277283號，「壓電致動馬達」，龔皇光、周卓明。(2007/03/21)
20. 中華民國發明第I 271362號，「容納裝置」，龔皇光、周卓明、劉于漳。(2007/01/21)
21. 龔皇光、黃柏文、陳鴻雄，2004，ANSYS與電腦輔助工程分析-網路e化精簡版，全華科技圖書公司。(ISBN 957-21-4462-6)
22. 陳永璋、陳建銘、龔皇光、李仁愛，2003，統計方法與品質管理，立誠圖書公司。(ISBN 957-30-8085-0)
23. 龔皇光、黃柏文、陳鴻雄，2002，ANSYS與電腦輔助工程分析，全華科技圖書公司。(ISBN 957-21-3589-9)

2.5 專業演講

1. Keynote speaker, 9th International Symposium in Science and Technology(2014)
2. 正修科技大學『跨國產業菁英論壇』邀請演講講座(2013)
3. 『2013台日韓建築與環境汙染防治國際研討會』邀請演講講座(2013)
4. 國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系演講 (2013)
5. 經濟部工業局『100年度產業人力扎根計畫成果發表會』邀請演講講座(2012)
6. 國立中興大學生物產業機電工程系邀請演講(2012)
7. 國立高雄應用科技大學模具工程系邀請演講(2011)
8. 國立高雄應用科技大學機械工程系邀請演講(2009)
9. 國立中興大學材料研究所邀請演講(2007)
10. 教育部產學發表會邀請演講(2007)
11. 義守大學機械工程系邀請演講(2006)
12. 國立中正大學機械工程系邀請演講(2005)
13. 國立清華大學動力機械工程系邀請演講(2004)

3.主持計劃

1. 科技部大專生研究計畫「半固態流變壓鑄成形之研究」，計畫主持人，NSC 104-2815-C-230-005-E。(2016)
2. 科技部提升私校能量專案整合型計畫「人類下肢骨板及其術後外骨架機器人輔具之工程分析與研製」，總計畫共同主持人，NSC102-2632-E-230-001-MY3，3年1200萬。(2013-2016)
3. Meic Auto(HK) Ltd. 公司「車用LED發光踏板改善計畫-蒸鍍膜成分與發光機制之製程改善」，計畫主持人，正研產學字(104)第032號，22萬1千1百元。(2015-2016)
4. 教育部大專校院未來想像與創意人才培育計畫-「作夥來CPR(Combing Puppetry and Robots)」，總計畫主持人，台教資(一)字第1030003347E，經費125萬。(2014-2015)
5. 科技部「半導體三維封裝層間下陷勁度之設計準則及未來銅線及鍍鈮銅線取代金線之評估」，計畫主持人，NSC101-2221-E-230-003，2012/08-2013/07，經費55萬。(2013)
6. 教育部青年發展署「第11屆全國高中職智慧鐵人創意競賽」初賽計畫，計畫主持人，台教青署輔字第1020000428號，經費28萬。(2013)
7. 科技部提升私校研發能量專案計畫「人類膝關節與其假體之工程分析與研製計畫」

- 整合型計畫共同主持人，NSC99-2632-E-230-001-MY3，2010/08-2013/07，經費1352.4萬。(2010-2013)
8. 堅晟機械工程有限公司「電力設備零組件材質分析」，計畫主持人，正研產學字(101)第032號，2012/8-2013/7，經費20萬。(2013)
 9. 教育部顧問室「第10屆全國高中職智慧鐵人創意競賽」初賽計畫，計畫主持人，台顧字第1010023965H號，經費22萬6176元。(2012)
 10. 教育部產業先進設備人才培育計畫2年期「智慧化工具機學程」，計畫主持人，台顧字第1000035016F號，經費132萬。(2012)
 11. 科技部「三維及多晶片封裝內不同跨距和金線高度之等偏移勁度設計對策及方法」，計畫主持人，NSC100-2221-E-230-016，2011/08-2012/07，經費57萬。(2012)
 12. 經濟部產業人才扎根計畫「五軸加工設計、製造與量測專業產業人才培育計畫」，計畫主持人，工研機字第1000014715號經費，93.85萬。(2012)(本計畫執行獲計畫績優獎)
 13. 至安重工有限公司「工程用金屬絞線機械性質分析與評估」，計畫主持人，正研產學字(101)第029號，2012/8-2012/12，經費60萬。(2012)
 14. 揚升實業有限公司「軟骨兩刷系統設計分析開發計畫」，計畫主持人，正研產學字(98)第323號，2010/07-2011/06，經費70萬。(2011)
 15. 教育部顧問室「第9屆全國高中職智慧鐵人創意競賽」初賽計畫，計畫主持人，台顧字第0990228597B號，經費26.7萬。(2011)
 16. 國科會「由偏移度及偏移勁度評估銅線取代金線於封裝製程之可行性研究與改善機制」，計畫主持人，NSC99-2221-E-230-005，2010/08-2011/07，經費64.3萬。(2011)
 17. 經濟部啟動產業人力扎根計劃「五軸加工精密製造與量測產業人才培育計畫」，計畫主持人，工研機字第0990012422號，2010/09-2011/07，經費106萬。(2011)(本計畫執行獲計畫績優獎)
 18. 教育部2009年啟動產業人力扎根計劃「五軸加工精密製造與量測產業人才培育計畫」，計畫主持人，教育部(台高通字第0980143539A號)/經濟部工業局(8453AG2100-063)，2009/09-2010/07，經費220萬。(2010)
 19. 國科會「高溫封裝下三維及多晶片模組金線偏移與金線鬆弛(回彈)能力之研究與控制」，計畫主持人，NSC98-2221-E-230-009，2009/08-2010/07，經費66.4萬。(2010)
 20. 經濟部學研聯合計劃(大產學)「織袋機凸輪機構設計與製造計畫」，子計畫主持人，((98)資案字第4858號)，2009/06-2010/05，600萬。(2010)
 21. 教育部「2009年台灣俄羅斯印度師生交流暨國際學術研討會」，計畫主持人，教育部台技(四)字第0980030421號，2009/03-2009/12，經費58萬，計畫主持人。(2009)
 22. 教育部「五軸加工精密製造與量測產業人才培育計畫」，計畫主持人，(台高通字0970153993)/經濟部工業局(經授工字09720411330)，2008/08-2009/07，經費303萬。(2009)
 23. 國科會「三維封裝及多晶片模組封裝大跨距之金線偏移及金線下陷問題探討」，計畫主持人，NSC97-2221-E-230-009，2008/08-2009/07，經費66萬。(2009)
 24. 明安國際企業公司「高爾夫球及複材球桿材料參數測試及技術建立計畫」，計畫主持人，正研建教字(97)第101號，2009/01-2009/12，經費40萬。(2009)
 25. 崇瑋工業股份有限公司「機車車體外觀設計與開發」，計畫主持人，正研產學字(96)第025號，2007/08-2008/07，經費30萬。(2008)
 26. 長聚興企業有限公司「軌道車輛用閘瓦性能評估與分析」，計畫主持人，正研產學字(96)第118號，2008/01-2008/12，經費15萬。(2008)

27. 「台灣俄羅斯學術交流計畫及國際學術研討會」，計畫主持人，教育部台技(四)字第0970047564號，2008/03-2008/12，經費76萬。(2008)
28. 教育部「TDK盃第12屆全國大專院校創思設計與製作競賽計畫」，計畫主持人，教育部台技(一)字第0970210693號/TDK台灣東電化公司基金會，2008/01-2008/12，經費經費教育部80萬/TDK基金會560萬計640萬。(2008)
29. 教育部2007年「五軸工具機精密加工與量測產業人才培育計畫」，計畫主持人，教育部(台高(一)字第0960136443號)/經濟部工業局(6453AG3100-65)，2007/09-2008/07，經費243萬。(2008)
30. 晉暉動力股份有限公司「D-cycle引擎性能測試分析」，計畫主持人，正研建教字(94)第070號，2006/07-2008/12，經費50萬。(2008)
31. 教育部「TDK盃第11屆全國大專院校創思設計與製作競賽計畫」，計畫主持人，教育部台技(三)字第0950198351號/TDK台灣東電化公司基金會，2007/01-2007/12，經費教育部100萬/TDK基金會560萬計660萬。(2007)
32. 教育部「奈米複合材料高爾夫球桿輕量化及揮桿衝擊性能分析計畫」，計畫主持人，教育部台技(三)字第0950175726F號，2007/01-2007/09，經費565萬。(2007)
33. 正熊機械股份有限公司「壓力容器鋼材機械性質分析」，計畫主持人，正研建教字(94)第086號，2006/07-2007/12，經費15萬。(2007)
34. 明安國際企業公司「碳纖維強化複合材料球桿之性能模擬、分析與實驗計畫」，計畫主持人，正研建教字(95)第028號，2007/01-2007/12，經費58萬。(2007)
35. 國科會「高溫封裝環境下半導體三維多層晶片微金線偏移特性探討」，計畫主持人，NSC94-2212-E-230-006，2005/08-2006/07，經費41萬。(2006)
36. 教育部「台灣俄羅斯雙邊學術工作研討會與『先進材料於複合負載下其塑性及破壞行為之研究與應用』國際交流合作先導型計畫」，計畫主持人，教育部台技(四)字第0950026581號，2006/03-2006/12，經費57萬。(2006)
37. 明安國際企業公司「以數值最佳化計算高爾夫球及球頭斜向碰撞與低溫材料實驗參數計畫」，計畫主持人，正建教字(94)第057號，2006/01-2006/12，經費66萬。(2006)
38. 國科會「微型光電元件加工技術及材料性質分析整合型計劃」，總計畫主持人，NSC93-2745-E-230-001，2004/05-2005/04，經費420萬。(2005)
39. 國科會「變迴圈之半導體多晶片及三維封裝金線偏移數值分析及實驗證明」，計畫主持人，NSC93-2218-E-230-001，2004/08-2005/07，經費38萬。(2005)
40. 教育部「台俄師資合作研究計畫」，計畫主持人，教育部台技(四)字第0940089102號，2005/08-2005/12，經費15萬。(2005)
41. 教育部「提升技專校院學生外語能力專案補助計畫-專業英文試驗教學法」，計畫主持人，2005/06-2005/12，經費120萬。(2005)
42. 勞委會「就業學程精密機械領域：半導體設備工程師」，計畫主持人，2004/08-2005/07，經費60萬。(2005)
43. 明安國際企業公司「高爾夫球頭及高爾夫球撞擊運動模擬分析(一)」，計畫主持人，正建教字(93)第069號，2005/07-2005/12，經費20萬。(2005)
44. 勞委會「九十二學年度就業學程精密機械領域：半導體設備工程師」，計畫主持人，2003/08-2004/07，經費30萬。(2004)
45. 教育部「光電半導體製程測量整合實驗室」，計畫主持人，2003/08-2004/07，經費280萬。(2004)
46. 教育部「半導體製程測量整合實驗室」，計畫主持人，教育部重點特色計畫台91技2字第91093057號，2002/08-2003/07，經費320萬。(2003)

47. 國科會「應用影像處理於複合材料疲勞損傷之分析」，計畫主持人，NSC91-2212-E-230-002，2002/08-2003/07，經費280萬。(2003)
48. 明安國際企業公司「高爾夫球頭材料開發與應用研究」，計畫主持人，正建教字(91)第043號，2003/07/01-2003/10/31，經費35萬。(2003)
49. 正修科技大學「工程研究科技中心」計畫，計畫主持人，正修科技大學專案，2001/01-迄今，經費1000萬。(2001-2011)
50. 至安重工有限公司「鋼絞線長期使用預力負載變化之探討分析」，計畫主持人，正建教字(91)第056號，2002/05-2002/08，經費22萬。(2002)
51. 明安國際企業公司「高爾夫球桿球頭模具開發可行性分析」，計畫主持人，正建教字(90)第040號，2002/04-2002/05，經費15萬。(2002)
52. 教育部「逆向工程實驗室設備整合計畫」，計畫主持人，教育部重點特色計畫，2000/08-2001/07，經費600萬。(2001)
53. 國科會「複材高溫氧化之理論預測與實證：由微結構探討表面粗度影響」，計畫主持人，NSC-89-2212-E-230-003，2000/08-2001/07，經費21萬。(2001)